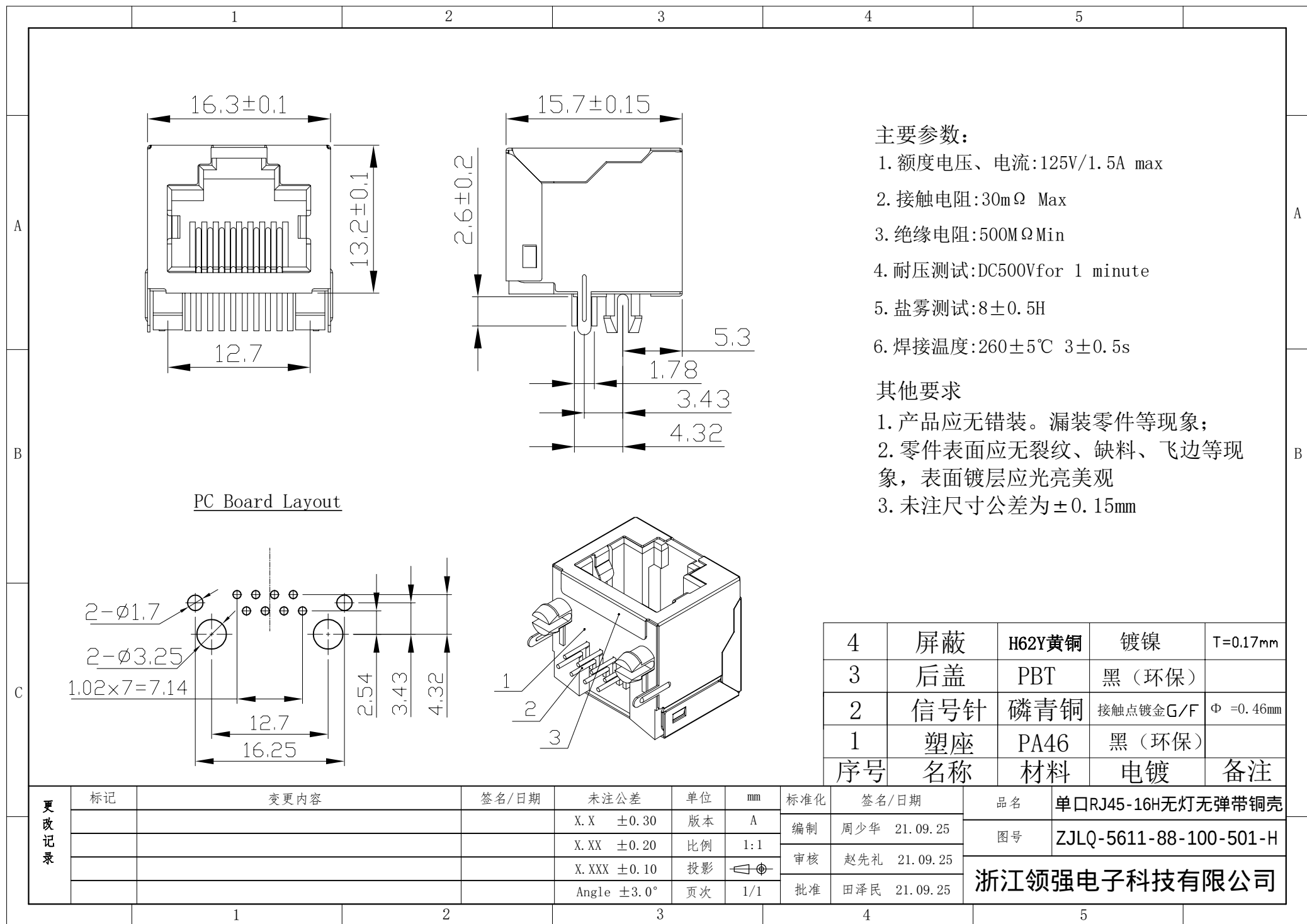




产品规范

MODULAR JACK CONNECTOR

目 录

1. 范围.....	2
2. 参考文件.....	2
3. 结构 & 组成.....	2
4. 额定值.....	2
5. 测试环境.....	2
6. 外观.....	2
7. 测试条件与要求摘要.....	2
8. 包装, 运输, 储存.....	4
9. 温度	4

版本	ECN 编号	变更履历	日 期	签 名
A0	N/A	初版发行	2017.10.26	

产品规范

MODULAR JACK CONNECTOR

1. 范围

本规范适用于 **MODULAR JACK CONNECTOR RJ45/RJ11** 系列产品。

2. 参考文件

除非特别说明，当此产品规范的要求与产品图有异议时以产品图为准；当此产品规范的要求与参考文件有异议时以产品规范为准。

- A. EIA-364：电子连接器和插座类产品测试方法。
- B. FCC 标准。

3. 结构&组成

产品的设计，结构和物理尺寸参照适用的产品图。

4. 额定值

项目	规格	
额定电压	125V	AC(rms)
额定电流	1.5A Max. at 25℃	
使用温度范围	-40℃ ~ +85℃	
使用湿度范围	95%R.H. MAXIMUM	

5. 试验环境

产品的设计应符合规定的电气，机械及环境性能。除非特别说明之外，一般试验及测量将于温度 15~35℃，相对湿度 25~85%，大气压力 86 ~106kPa 之条件下完成，但若上述条件下有任何影响判定值的疑虑，可考虑在温度 20 ±2℃，相对湿度 60~70%及大气压力 86~106kPa 之条件下完成试验。

6. 外观

经目视观察，外观不可有变形，电镀脱落等会降低其功能的异常现象，也不可有严重破裂、刮伤或污损之缺点。

7. 测试条件及要求摘要

7.1 电气特性

编号	项 目	条 件	规 格
7.1.1	接触阻抗	EIA364-23 在配对好公头与插座上进行测试。 开路电压：20mV 以下 电流：100mA 以下	35mΩ Max.
7.1.2	绝缘阻抗	EIA364-21 在连接器相邻电流间或与接地端进行测试。 电压：500V DC.	1000MΩ Min.
7.1.3	耐电压	EIA 364-20 在连接器相邻电流间或与接地端进行测试。 电压：1000V AC 50 或 60HZ，持续 1 分钟。	无击穿或火花发生 漏电流：< 1.5mA

产品规范

MODULAR JACK CONNECTOR

7.2 MECHANICAL PERFORMANCE [机械特性]

编号	项 目	条 件	规 格	
7.2.1	插入力	EIA 364-13 操作速度: 不超过 10mm/秒速度, 测量插入水晶头所需的力。	22N (2.24Kgf) Max.	
7.2.2	拔出力	EIA 364-13 操作速度: 不超过 10mm/秒速度, 测量拔出水晶头所需的力。(水晶头除去锁扣舌片)	22N (2.24Kgf) Max.	
7.2.3	配合强度	EIA 364-98 配对插头与插座, 以不超过 10mm/秒的速度, 测量拔出插头所需的力。	50N (5.10Kgf) Min.	
7.2.4	机械寿命	EIA 364-09 操作速度: 不超过 300 次/小时和 10mm/秒速度, 插拔次数: 750 次, 水晶头锁扣舌片处于无功能状态。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50mΩ Max.
7.2.5	可焊性	EIA 364-52 产品锡脚放置在助焊剂中浸润 5S 后再插入锡炉中 2mm 深进行粘锡测试。 焊锡温度: 245±3℃; 焊锡时间: 5±0.5 秒 (使用助焊剂)。	最少 95%的沾锡面积。	

7.3 环境特性及其它

编号	项 目	条 件	规 格	
7.3.1	耐焊接热	EIA 364-56 人工焊: 3±1 秒 350±10℃; 自动焊: 260±5℃, 10±1 秒	外观	不可损坏
7.3.2	耐高温	EIA-364-17 配对插头与插座, 温度 85±2℃, 持续 96 小时。经试验后, 连接器须于室温中放置 1~2 小时, 再测定其值。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.
7.3.3	耐低温	EIA-364-59 配对插头与插座, 温度-40±2℃, 持续 96 小时。经试验后, 连接器须于室温中放置 1~2 小时, 再测定其值。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 mΩ Max.

(继续)

产品规范

MODULAR JACK CONNECTOR

编号	项 目	条 件	规 格	
7.3.4	温度循环	EIA-364-32 配对插头与插座, 在温度 $-40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 箱体放置 0.5 小时, 然后在 $85\pm 2^{\circ}\text{C}$ 箱体中放置 0.5 小时, 5 个循环后取出样品在室温中恢复 1~2 小时。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 m Ω Max.
7.3.5	耐湿性	EIA 364-31 配对插头与插座, 在温度 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$, 湿度 90~95%RH 的箱体放置 96 小时, 取出样品在室温中恢复 1~2 小时。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 m Ω Max.
			绝缘阻抗	500 M Ω MIN.
			耐电压	500 VAC, 1 分钟
7.3.6	盐水喷雾	EIA-364-26 将配对的插头与插座放置于 PH 值为 6.5~7.2 的 $5\pm 1\%$ NaCl 盐雾环境中, 测试完成后, 用清水冲洗样品, 在室温中恢复 1 小时。 盐雾时间 (镀金): (Fu"、G/F): 12 小时, (3u"~10u"): 24 小时, (15u"~30u"): 48 小时。	外观	不可损坏
			接触阻抗	50 m Ω Max.

注意: 产品如果是由 PBT 组成, 在焊接过程中定位柱可能会出现熔胶现象 (熔胶温度为 $\geq 230^{\circ}\text{C}$, 时间为 3 秒后)。
(结束)

8. 包装、运输、储存

8.1 包装

产品应装在干燥的、防潮的、防尘和防霉箱子中。包装箱的外表部应注明相应产品名称、型号、料号、数量以及日期、检验印章等。

8.2 运输

包装成箱的产品, 在避免雨雪直接淋袭的条件下, 可用任何运输工具运送。

8.3 储存

包装成箱的产品, 建议在环境温度 $-10\sim +40^{\circ}\text{C}$, 相对湿度不大于 80%内保管, 应储存在周围空气没有酸性、碱性或其它腐蚀性气体的库房中。若需长期保存, 请勿打开包装箱。

MODULAR JACK CONNECTOR

9. 波峰焊曲线图

SUGGESTED WAVE SOLDER CURVE

